

# 高品质金电镀工艺

凭借表面处理技术与卓越成果，开创价值新纪元



金电镀是一种兼具优异导电性、耐腐蚀性和外观品质的表面处理技术，广泛应用于电子元件、精密仪器、医疗设备以及装饰品等多个领域。

随着产品功能的提升与高可靠性需求的增加，针对不同用途选择合适的金电镀工艺显得愈发重要。

在ERG，我们提供两种硬质金电镀和金-镍电镀，并可支持无电解金电镀的试作。我们能够根据产品规格和使用环境，灵活满足膜厚、硬度、镀层附着力及外观等技术要求，并建立了完善的体制，可从试作到量产为客户提供全方位支持。

## ERG的镀金工艺

电镀种类	金纯度 (Au)	合金成分	硬度 (HV)	主要用途示例	特长
硬质金电镀 (A型)	99.7~99.99%	Co	约160~210	接触部件 线键合(Wire Bonding)	具备优良的柔软性 导电性与可焊性
硬质金电镀 (B型)	97~98%	Co	约250~300	接触部件 开关	耐磨耗性·长期可靠性
金-镍电镀	99%	Ni	约280~350	滑动接点 易磨损部件	高硬度·抗变色性
无电解金电镀	99%以上	请联系我们	请联系我们	微细电极 UBM形成	均匀性·适应复杂形状·无需电流

我们能够同时支持有底镀层与无底镀层两种工艺方案，灵活满足不同产品的需求。

### ●有底镀层工艺

根据不同的用途与基材施加适当的底镀层处理，可以有效提升金电镀的附着力、耐蚀性以及外观品质。

- 下地铜电镀 : 具有优异的导电性能，并且与厚镀金工艺相容性良好
- 下地镍电镀 : 具有优异的附着力与平滑性，非常适合用于电子部件和精密部件
- 下地无电解镍电镀 : 可适用于复杂形状及非导电性基材，具备广泛的适应能力
- Olympic 电镀 (下地铜+银) : 针对特殊用途的 Cu→Ag→Au 多层结构

### ●无底镀层工艺

无需施加底镀层，也可直接形成金电镀。同时能够适用于微细部件及特殊形状，具备灵活的工艺适应性。



## (FAQ) 常见问题解答

- Q. 金镀层的膜厚一般是多少？  
A. 通常为 0.05~2 μm，可根据不同用途进行灵活调整。
- Q. 是否符合 RoHS 环保规范？  
A. 已全面符合。产品不含铅、汞等有害物质，安全可靠。

#企业官方账号



**ERGco.,LTD.**

群馬县富岡市宇田250-6  
TEL 0274-62-2421  
FAX 0274-64-2379

